超导转变边沿探测器的电热仿真

吕越1,高波2

1.超导电子学卓越创新中心,上海微系统与信息技术研究所,上海市 2.超导电子学卓越创新中心,上海微系统与信息技术研究所,上海市

简介:超导转变边沿探测器(TES)是一种电压偏置的电热器件,稳态时超导薄膜产生的焦耳热与通过热连接传递到热沉的热量相等。本文利用有限元仿真软件 COMSOL Multiphysics® 对处于热平衡的TES进行了电流-热传导仿真。得到稳态时TES器件的温度分布,并计算得到TES器件的关键参数热导G,同时得到了器件处于稳态时薄膜温度与偏置电压(V-T)的关系,这对于器件设计有着极大的帮助。

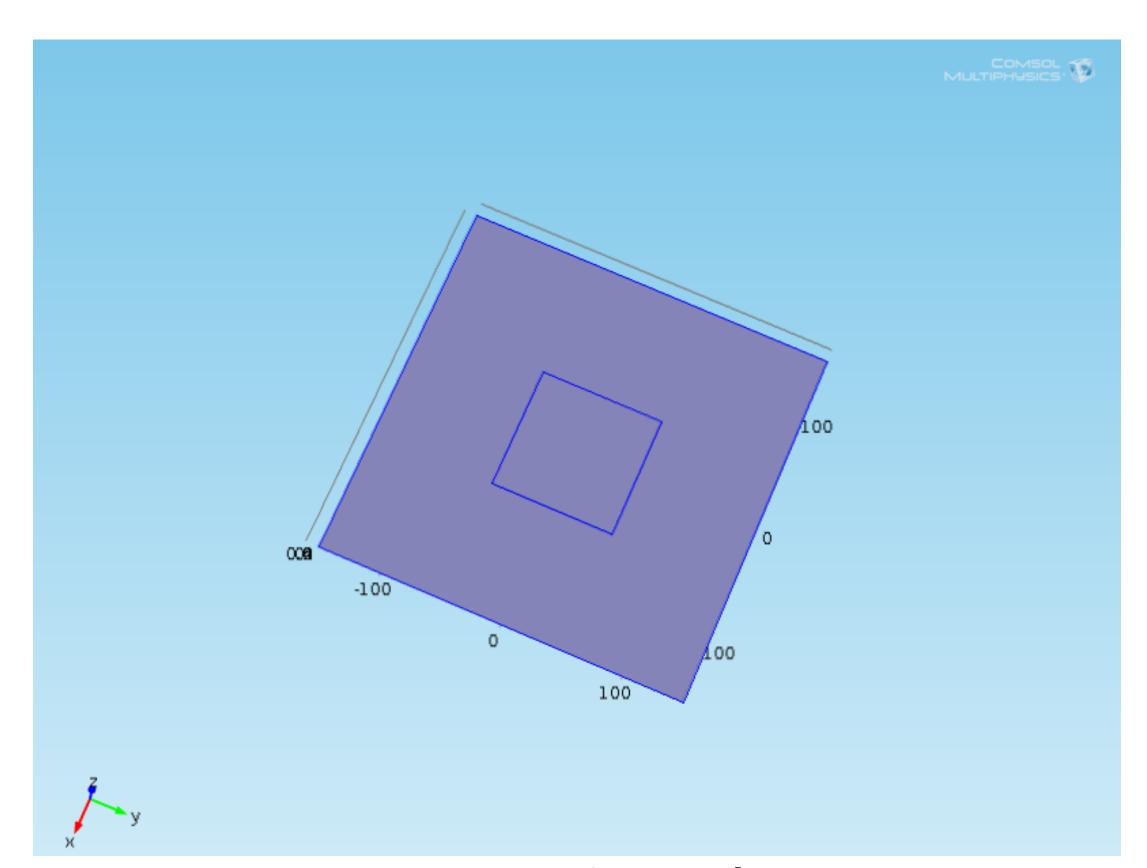


图 1. TES器件示意图

计算方法: 描述仿真中主要包括两个模块, 电流守恒和热传导模块, 电流守恒及热传导方程如下。器件材料极低温属性如表1。

$$abla \cdot J = Q_j$$

$$J = \sigma E + J_e$$

$$E = -\nabla V$$

$$\rho \mathbf{C}_{\mathbf{p}} \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{T} = \nabla \cdot (k \nabla \mathbf{T}) + Q_j$$

AlMn薄膜通过电压偏置产生焦耳热,同时,热量通过Si₃N₄导走到热沉,实现热稳态,使AlMn薄膜温度稳定在超导转变边内。

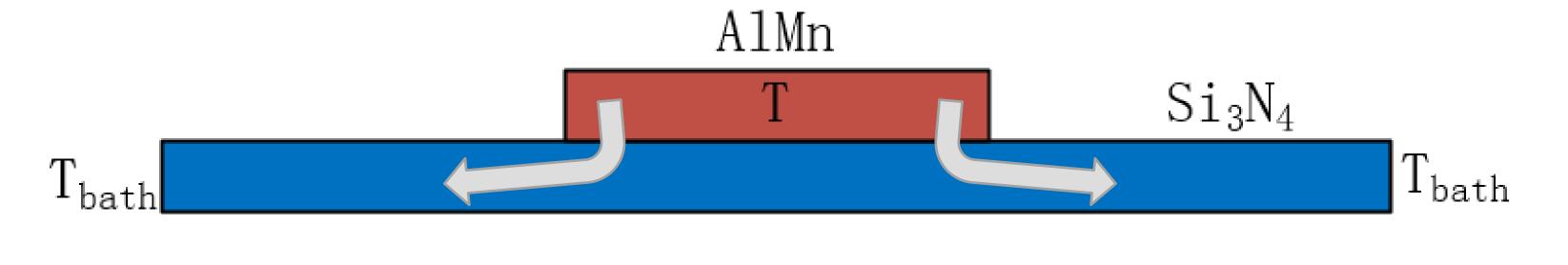


图 2.器件热传导示意图

结果: 器件的温度分布图如图3,根据热导公式1/G=k1/s可以计算得到器件中 Si_3N_4 的热导G,最后由 $\frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{R}}=G(T-T_{bath})$ 达到器件偏置电压Vbias与器件温度T的关系如图4所示。

变量	数值	单位
AIMn常压热容	0.5*T	J/(kg*K)
AIMn导热系数	15*T	W/(m*K)
Si ₃ N ₄ 常压热容	25*T ²	J/(kg*K)
Si ₃ N ₄ 热导系数	0.015*T ²	W/(m*K)

表 1. 器件极低温属性

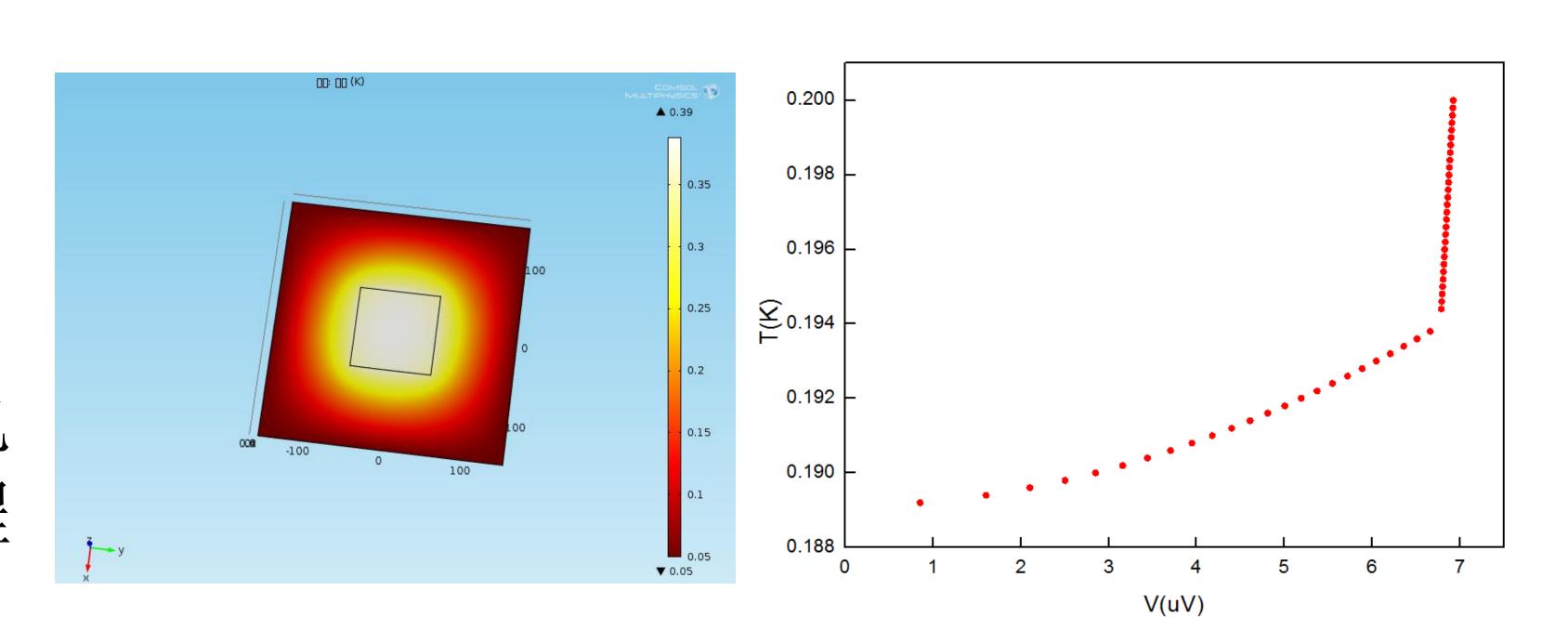


图 3.器件温度分布图 图 4.稳态温度与偏置电压的关系

结论:利用商业有限元仿真软件 COMSOL Multiphysics® 可实现低温探测器的快速准确求解,解决了包括TES器件热容及热导计算、偏置电压与温度的关系(V-T)、薄膜内部温度分布等问题;探测器薄膜的温度和热导率分布均可通过 COMSOL 直观地展现。

参考文献:

1. K. D. Irwin and G. C. Hilton, Transition-Edge Sensors 2. 王天顺,超导转变边缘传感器的建模仿真及实验表征